

**Con la presente si comunica che il giorno 16 febbraio alle ore 10 presso la Sezione INFN di Pisa Largo Pontecorvo 3, Edificio C, avverrà l'apertura in seduta pubblica della busta amministrativa relativa alla gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di interconnessione tramite flip-chip bump bonding del chip di readout e del sensore per l'esperimento PixFEL (Lotto A) e per l'upgrade di Fase II del rivelatore a pixel di CMS nell'ambito dell'esperimento RDFASE2 (Lotto B).
Riferimento Atto G.E. n.11204 del 16/11/2016**

**Cordiali saluti,
Roberto Dell'Orso
Responsabile Unico del Procedimento**